

Lasertec

株主通信

第53期 第2四半期

(2014年7月1日～2014年12月31日)

世界中のお客さまから真っ先に
声をかけていただける会社に

技術革新に伴う新たな課題解決をどこよりも早く提供し、
お客さまの期待にこたえてまいります。



Lasertec News 12



さらなる業績向上と 成長を目指して

レーザーテック株式会社 代表取締役社長 岡林 理

第2四半期の業績報告

株主の皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

当第2四半期の世界経済は、米国で堅調な成長が継続する一方、欧州での景気悪化や中国をはじめ新興国における成長率の鈍化などがあり、不透明な状況が続きました。わが国経済は、円安メリットにより輸出関連企業等に好業績もみられましたが、全体としては、消費税増税後の景気停滞からの回復に時間を要しています。

当社を取り巻く事業環境につきましては、スマートフォン向け半導体が堅調で、最先端の微細化投資が始まりました。当社が参入しているその他の事業領域に関しまして

は、FPD業界で、スマートフォン用の高精細パネルの生産に使われるフォトマスク向けの設備投資が活況でした。太陽電池業界やリチウムイオン電池業界は、製品価格の下落が続いているものの、着実に市場は成長しました。

このような状況下、当第2四半期の業績につきましては、増収増益となりました。売上高は61億79百万円(前年同期比12.8%増)、営業利益は17億51百万円(同106.8%増)、また純利益は11億82百万円(同94.1%増)と、前年同期を上回りました。

売上高につきましては、半導体用マスクブランクス欠陥検査装置MAGICSや高精細FPD用マスク欠陥検査装置CLIOSが好調に推移し、利益につきましては、製品構成の変化、円安による為替差益、および売上の増加などに

より大幅増となりました。

今後の見通しとしましては、通期で売上高は150億円(前年度比10.2%増)、営業利益38億円(同22.7%増)、純利益24億円(同21.9%増)を見込んでおります。期初の業績予想から売上は変更ありませんが、利益につきましては増益を予想しております。

■ 新中期経営計画のフェーズ I について

2015年6月期は、新中期経営計画におけるフェーズ I (第51期～第53期(2012.7～2015.6))の最終年度です。このフェーズ I 「新たな挑戦」では、次の目標を掲げています。

1 コアビジネスの強化

2 新規事業の柱を一つ立ち上げる

「1.コアビジネスの強化」では、主力製品である半導体用マスク欠陥検査装置MATRICSとマスクブランク欠陥検査装置MAGICSを引き続き強化し、微細化の進展に貢献してまいります。また液晶パネル等の高精細化に対応したFPD用マスク欠陥検査装置CLIOSの普及促進と顕微鏡のさらなるシェア拡大を目指します。

「2.新規事業の柱を一つ立ち上げる」では、ウェハ検査装置WASAVIシリーズの製品で、新規事業を確立してまいります。具体的には、国内では既に業界標準機としての地位を確立しつつあるSiC等の透明ウェハ欠陥検査/レビュー装置SICA、TROISの海外展開を強化します。その他、半導体の高集積化・高性能化に向けた新たなデバイスとして期待されている3次元積層デバイスの生産工程用

TSV裏面研磨プロセス測定装置BGM300や、ウェハ上のパターンのばらつきなどの高速検査を可能にしたリソグラフィプロセス検査装置LX330を中心に、新規事業の確立に向けた取り組みを強化してまいります。

レーザーテックは、『世界中のお客さまから真っ先に声をかけていただける会社』というビジョンの実現に向け、お客さまのニーズに対して、どこよりも早くソリューションを提供できる新製品を継続的に開発し、さらなる業績向上と成長を目指してまいります。株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

1 コアビジネスの強化



大型フォトマスクパターン
欠陥検査装置

CLIOS G821

2 新規事業の柱を一つ立ち上げる



リソグラフィ
プロセス検査装置
WASAVIシリーズ

LX330

WASAVIシリーズ ウェハ バンプ検査測定装置 BIM300 新製品発売(2014年11月13日)

半導体デバイスのさらなる高性能化に向けて、微細化と並行してシリコン貫通電極※1 (TSV) などを用いた3次元積層デバイス※2の開発、量産化に向けての取り組みが進んでいます。

この3次元積層デバイスの積層工程において、重ね合わせるウェハ上の接点となるバンプ※3とパッド間の安定接合の実現が、歩留まり向上のための大変重要な課題となっています。ウェハ表面に形成するバンプを用いたデバイス間の接合は、以前より行われておりましたが、最新の3次元積層デバイスではバンプの微細化が進み、0.1ミクロン程度の精度で高さ・幅などを測長する必要があります。また、ウェハ薄化後のTSVの露出量なども従来以上の高い精度で測定し、管理することが求められています。

新製品BIM300は、このような課題に対応すべく開発した製品です。当社の永年にわたる工業用レーザー顕微鏡の基本技術に、高精度ステージを組み合わせ、ウェハ表面のカラー画像による高解像度観察、バンプの高さ・幅・形状、およびシリコン貫通電極の非接触高精度測定を実現しました。

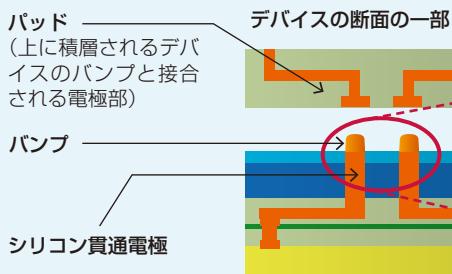


※1 シリコン貫通電極：デバイス間の信号やり取りのために、デバイスを垂直に貫く電極。従来のワイヤボンディング接続と比較して、デバイスの高速度・省電力化・高機能化が可能。

※2 3次元積層デバイス：同種または異種のチップを積層することで、空間集積度を高めたデバイス。特に、チップ間の接続にシリコン貫通電極が用いられたデバイスと呼ぶことが多い。従来の線幅微細化による集積度向上にコスト的・技術的制約が見え始めていることから、近年実用化に向けて盛んに開発されている。

※3 バンプ：重ね合わせるデバイスと電気的な接続をするために作られたデバイス上の金属電極。安定した電氣的接続を実現するために柔らかい金属で作られることが多い。

3次元積層デバイスにおけるシリコン貫通電極とバンプのイメージ

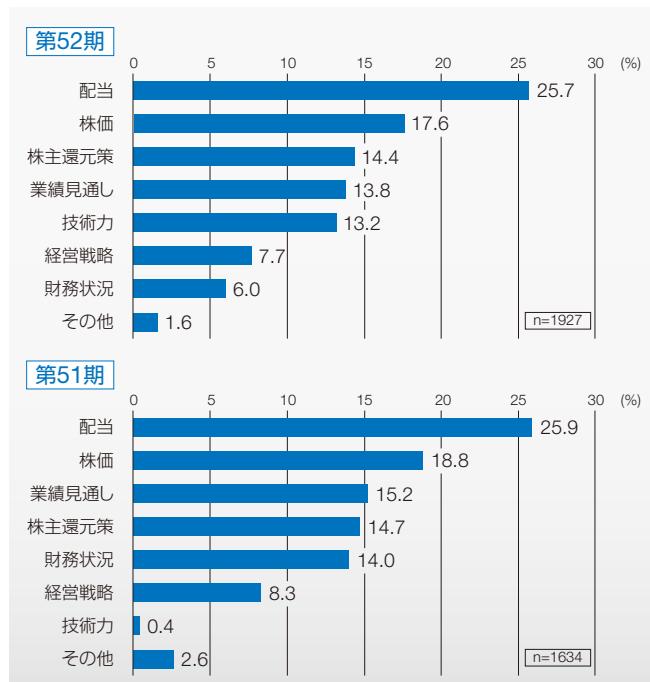


当社コンフォーカル顕微鏡で撮像したバンプ像の例

株主さまアンケート結果のご報告

Lasertec News 11同封のアンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうございました。今回は、853名(回答率17.5%)の株主さまよりご回答をいただきました。集計結果の一部をご報告いたします。

当社の株式を買い増し・長期に保有していただくために何を重要視されますか？(複数回答可)



当社の株式を買い増し・長期に保有していただくための判断材料として、前期同様、配当と株価が上位になりました。当社は、利益還元のさらなる充実、株主層の拡大を図るため、より積極的な株主還元策として、第53期(2015年6月期)より連結配当性向の目安を従来の30%から35%に引き上げました。また、今回は技術力のポイントも大きく上がっており、引き続き技術の幅、厚みを広げ業績に反映させてまいります。

自由記述欄にご要望をご記入いただきました株主さまにおこたえいたします。

ご要望 1

オンリーワンとなり、よりグローバルに展開されることを望みます。

世界の製造装置の主要市場である米国、台湾、韓国に現地法人を設立しております。それぞれの体制や営業力の強化を進め、前期、海外売上比率は80%を超えました。本社のサポート体制の強化や、各種仕組みの共通基盤の構築を推進することで、グローバル企業として確実な成長を図ってまいります。

ご要望 2

特許公報等からも、技術力のある会社と理解しています。ただ、素晴らしい技術が必ずしも収益に結びつかない場合もありますので、お客さまが望む技術を提供できる会社になってください。

当社は、独自の技術力やスピード開発を強みとしていますが、ご指摘のとおり、これらを用いてお客さまに貢献できなければ、業績には結びつきません。ソリューションセールス部を強化して、お客さまが望む技術や、潜在的なニーズを製品開発に組み込み、お客さまに真の課題解決をご提案できる体制づくりを進めてまいります。

ご要望 3

業績見通し、株主還元策に納得できれば、また株を購入したいと考えています。

新中期経営計画「フェーズI」の基本方針である「コアビジネスの強化」と「新規事業の柱の一つ立ち上げる」の遂行で、業績の継続的向上を図りながら、積極的な還元を進めてまいります。

今後も、株主さまからの貴重なご意見・ご要望を経営に反映させるよう、引き続き努力してまいります。また、創業以来培われてきた当社独自の技術力をさらに発展・進化させ、株主さまのご期待におこたえしてまいります。

2015年6月期(第53期第2四半期)の連結決算のご報告

連結貸借対照表(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当第2四半期 2014年12月31日	前第2四半期 2013年12月31日	前連結会計年度 2014年6月30日	科目	当第2四半期 2014年12月31日	前第2四半期 2013年12月31日	前連結会計年度 2014年6月30日
資産の部				負債の部			
流動資産	13,889	12,193	14,303	流動負債	2,906	3,214	3,997
				固定負債	215	366	227
				負債合計	3,122	3,581	4,224
固定資産	7,378	7,419	7,383	純資産の部			
				株主資本	17,874	15,938	17,300
				① 純資産合計	18,145	16,031	17,463
資産合計	21,268	19,612	21,687	負債純資産合計	21,268	19,612	21,687

連結損益計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

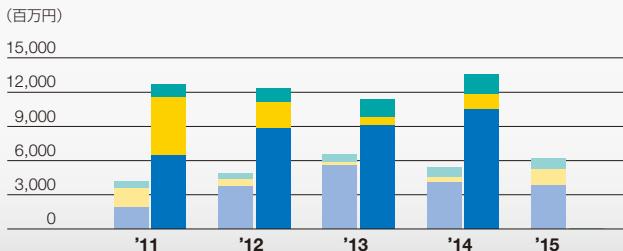
科目	当第2四半期 (自2014年7月1日 至2014年12月31日)	前第2四半期 (自2013年7月1日 至2013年12月31日)	前連結会計年度 (自2013年7月1日 至2014年6月30日)
② 売上高	6,179	5,476	13,607
売上原価	2,717	3,025	7,041
売上総利益	3,462	2,450	6,565
販売費及び一般管理費	1,711	1,604	3,467
③ 営業利益	1,751	846	3,097
③ 経常利益	1,775	922	3,161
③ 四半期(当期)純利益	1,182	609	1,969

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当第2四半期 (自2014年7月1日 至2014年12月31日)	前第2四半期 (自2013年7月1日 至2013年12月31日)	前連結会計年度 (自2013年7月1日 至2014年6月30日)
④ 営業活動による キャッシュ・フロー	△2,083	△1,149	3,909
投資活動による キャッシュ・フロー	△30	△28	△83
財務活動による キャッシュ・フロー	△609	△193	△1,720
現金及び現金同等物の 期首残高	6,120	3,967	3,967
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	3,469	2,669	6,120

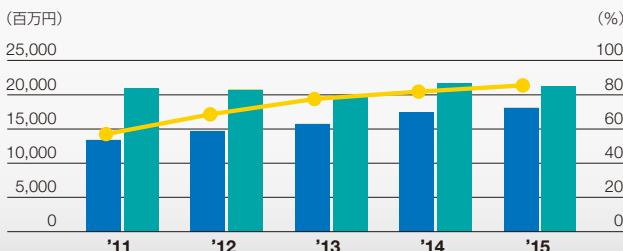
製品別売上高



■ 半導体関連装置 (第2四半期/通期) ■ その他 (第2四半期/通期)
■ サービス (第2四半期/通期)

※2014年6月期より、これまでのFPD関連装置およびレーザー顕微鏡の売上高は、その他とすることに変更し、2011年6月期以降の製品別売上高も遡及修正しています。

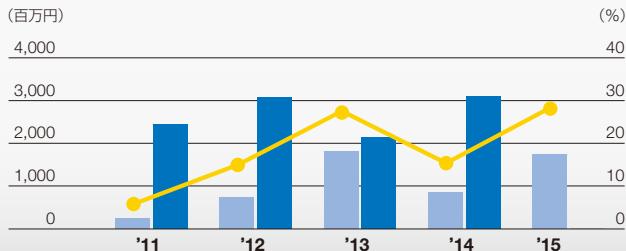
自己資本・資産合計・自己資本比率



■ 自己資本* ■ 資産合計* ● 自己資本比率 (第2四半期/右軸)

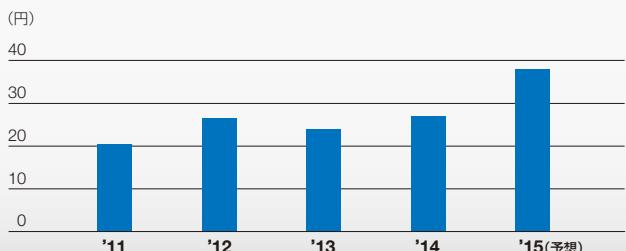
*'11-'14:通期 '15:当第2四半期

営業利益・営業利益率



■ 営業利益 (第2四半期/通期) ● 営業利益率 (第2四半期/右軸)

年間配当金



※2013年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。上記の数字は株式分割が2011年6月末時点で実施されたものとして計算したものです。

※第2四半期:7月1日~同年12月31日 通期:7月1日~翌年6月30日

《 決算のポイント 》

① 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は181億45百万円となりました。自己資本比率は85.2%で、引き続き財務の健全性を維持しています。

② 売上高

円安による売上の増加と、半導体関連装置の売上一部前倒しにより、期初予想を上回りました。

③ 営業利益、経常利益、四半期純利益

製品構成の変化、円安による為替差益、売上の増加などにより、利益は大幅増となりました。

④ 営業活動によるキャッシュ・フロー

これは主に、売上債権の増加、法人税等の支払いなどの支出要因が、税金等調整前四半期純利益などの収入要因を上回ったことによるものです。

会社概要 (2014年12月31日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 253名 単体 188名

役員

代表取締役社長	岡林 理	社外取締役	梶川 信宏
代表取締役副社長	楠瀬 治彦		海老原 稔
常務取締役	内山 秀		下山 隆之
取締役	森泉 幸一	常勤監査役	古賀 一正
		監査役	齋藤 侑二
			山田 博重

株式情報 (2014年12月31日現在)

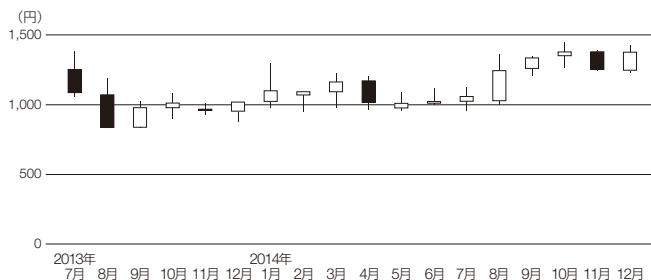
株式概要

上場市場	東京証券取引所市場第一部(証券コード6920)
発行済株式総数	23,571,600株
株主数	4,527名
大株主一覧	

	所有株式数(株)	持株比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,211,500	5.13
内山 靖子	1,001,600	4.24
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	916,700	3.88
内山 洋	870,800	3.69
株式会社三菱東京UFJ銀行	752,000	3.19
内山 秀	697,000	2.95
前田 せつ子	646,800	2.74
HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500	555,600	2.35
HKMPF 10 PCT POOL		
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	515,600	2.18
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224	500,900	2.12

(注)上記のほか、当社は発行済株式総数に対し、4.36%の自己株式を保有しています。

株価の推移



株主メモ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)

単元株式数

100株

株主名簿管理人

三菱UFJ信託銀行株式会社

特別口座管理機関

同連絡先
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL

<http://www.Lasertec.co.jp>

ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の本店でお支払いいたします。

当社Webサイトのご案内

<http://www.Lasertec.co.jp>

当社Webサイトには、IR情報をはじめ各種情報が掲載されております。ぜひご覧ください。

